

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



















Hochtemperaturfeste Stiftleiste im Raster 3,50 mm.

- Steckrichtung parallel (90°), gerade 180° oder schräg (135°) zur Leiterplatte
- Gehäusevarianten: seitlich geschlossen (G),
 Schraubflansch (F), Lötflansch (LF) oder Rast-Lötflansch (RF)
- Optimiert für den SMT-Prozess
- Stiftlänge 3,2 mm universell für alle Lötverfahren
- Stiftlänge 1,5 mm optimiert für Reflow-Lötverfahren
- Verpackt im Karton (BX) oder Tape-on-Reel (RL)
- Stiftleiste kann kodiert werden

Allgemeine Bestelldaten

eiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch,
ΓHT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°,
ötstiftlänge (I): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
1000620000
SL-SMT 3.50/06/90RF 1.5SN BK BX
1032248838035
50 Stück
EC: 320 V / 15 A
JL: 300 V / 10 A
Box



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	11,1 mm	Tiefe (inch)	0,437 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Höhe niedrigstbauend	7,5 mm	Breite	27,86 mm
Breite (inch)	1,097 inch	Nettogewicht	2,096 g

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie	Anschlussart	
Floudktiamme	BL/SL 3.50	Alischiussart	Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss	Raster in mm (P)	3,5 mm
Raster in Zoll (P)	0,138 "	Abgangswinkel	90°
Polzahl	6	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (I)	1,5 mm	Lötstiftlänge-Toleranz	0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen	d = 1,2 mm, oktogonal	Lötstift-Abmessungen=d Toleranz	0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)		Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz	:
	1,4 mm	(D)	+ 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge	2,3 mm	Schablonenloch Durchmesser	2,1 mm
L1 in mm	17,5 mm	L1 in Zoll	0,689 "
Anzahl Reihen	1	Polreihenzahl	1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingers. gesteckt/ handrü- ckens. ungest.	Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart	IP10	Durchgangswiderstand	≤5 mΩ
Kodierbar	Ja	Steckzyklen	25
Steckkraft/Pol, max.	6 N	Ziehkraft/Pol, max.	6 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	verzinnt	Schichtaufbau - Lötanschluss	23 µm Ni / 57 µm Sn
Schichtaufbau - Steckkontakt	23 µm Ni / 57 µm Sn	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-30 °C
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	15 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
(Tu=20°C)	12 A	(Tu=40°C)	13 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsspannung bei Überspan-	
(Tu=40°C)	10 A	nungsk./Verschmutzungsgrad II/2	320 V
Bemessungsspannung bei Überspan-		Bemessungsspannung bei Überspan-	
nungsk./Verschmutzungsgrad III/2	160 V	nungsk./Verschmutzungsgrad III/3	160 V
Bemessungsstoßspannung bei Über-		Bemessungsstoßspannung bei Über-	
spannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	2,5 kV	spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Über-		Kurzzeitstromfestigkeit	
spannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	2,5 kV		3 x 1s mit 100 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)	300 V	Nennspannung (Use group D / CSA)	300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)	10 A	Nennstrom (Use group D / CSA)	10 A

Erstellungs-Datum 21. Mai 2024 16:30:16 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR)		Zertifikat-Nr. (UR)	
	74		E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)	300 V	Nennspannung (Use group D / UL 1059)	300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)	10 A	Nennstrom (Use group D / UL 1059)	10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximal- werte, Details siehe Zulas- sungs-Zertifikat.		
Verpackungen			
Verpackung	Вох	VPE Länge	98 mm
VPE Breite	88 mm	VPE Höhe	38 mm
Klassifikationen			
ETIM 6 O	EC002637	ETIM 7.0	EC002627
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002637 EC002637	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002637 EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-46-02-01
Michainen Himmin			
Wichtiger Hinweis			
IPC-Konformität	und ausgeliefert und entspreche	en nach international anerkannten Standards u en den zugesicherten Eigenschaften im Datenbl PC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Al	latt bzw. erfüllen dekorative Ei-
Hinweise	Vergoldete Kontaktoberfläche	en auf Anfrage	
	Bemessungsstrom bezogen a	uf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl	
	• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm		
	• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole		
	• Zeichnungsangabe P = Raste	r	
	Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.		
	 OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. 		
	 Langzeitlagerung des Produkt tigkeit von 70 %, 36 Monate 	ts bei einer Durchschnittstemperatur von 50°C	und einer maximalen Luftfeuch-



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	<i>71</i> 2

ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E60693

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-	-
kument	Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL DRIVES EN
	MB SMT EN
	FL DRIVES DE
	MB DEVICE MANUF. EN
	FL BUILDING SAFETY EN
	FL APPL LED LIGHTING EN
	FL INDUSTR.CONTROLS EN
	FL MACHINE SAFETY EN
	FL HEATING ELECTR EN
	FL APPL_INVERTER EN
	FL_BASE_STATION_EN
	FL ELEVATOR EN
	FL POWER SUPPLY EN
	FL 72H SAMPLE SER EN
	PO OMNIMATE EN
	PO OMNIMATE EN
Whitepaper surface mount technology	Download Whitepaper



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

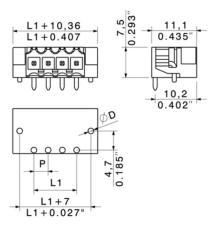
www.weidmueller.com

Zeichnungen

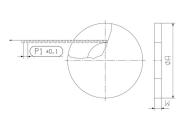
Produktbild



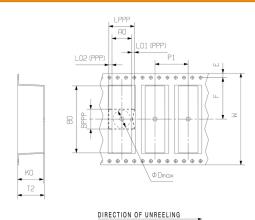
Maßbild



Maßbild



Maßbild



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel





Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.





Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.